

Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung einer primären
Einzelverpackung eines Wafers

5 Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung
zur Herstellung einer primären Einzelverpackung eines
Wafers, insbesondere eines aus einem Wirkstofffilm eines
oder mehrerer Wirkstoffe entnommenen Wafers zur Verwendung
als Dosiereinheit- und Darreichungsform für Arzneimittel.

10

Neben den bekannten Dosierformen für Arzneimittel, wie
Tabletten, Kapseln, Tropfen oder ähnlichen Darreichungs-
formen, gibt es auch die Darreichungsform des „Wafer“. Es
handelt sich bei diesem um ein dünnes Plättchen aus einem
15 Wirkstofffilm mit einer vorbestimmten Wirkstoffmenge, das
in seiner Dicke und seinen Abmessungen auf die abzugebende
Wirkstoffmenge abgestimmt ist. Ein Wafer ist flexibel,
weich, von geringem Gewicht und reißfähig. Da die Kontakt-
fläche des Wafers im direkten Zusammenhang mit der Dosier-
20 menge des Wirkstoffs steht, müssen seine Abmessungen
weitestgehend mit den errechneten übereinstimmen und im
Toleranzbereich liegen. Wegen der Abhängigkeit der
Dosierung von der Fläche darf das weiche Wirkstofffilm-
material vor dem Schneiden nicht gedehnt werden, da sonst
25 die Wirkstoffmenge verändert werden würde. Daher sind die
Herstellung des Wafers und dessen Einzelverpackung oder die
Verpackung mehrerer Wafer in eine Primärverpackungseinheit
auch aufwendig.

30

Aus der DE 198 00 682 A1 ist ein Verfahren zur Herstellung
einer Primärverpackungseinheit für film- oder oblatenartige
Darreichungsformen (Wafer) zur oralen Applikation mit je
einem Abschnitt einer Packstoffober- und -unterbahn be-
kannt. Das grundsätzlich auch auf Einzelverpackungen von
35 Wafers anwendbare Verfahren hat für quadratische oder
rechteckige Wafer einen unterschiedlichen Verfahrensablauf

gegenüber der Herstellung von Wafern mit einer anderen
Gestalt. Für quadratische oder rechteckige Wafer werden in
einem ersten Schritt eine Packstoffoberbahn und eine -
unterbahn ohne Kalt- oder Heißverformung über jeweils eine
5 Umlenkswelle aufeinandergeführt, wobei gleichzeitig die
film- oder oblatenartige Darreichungsform mit Hilfe von
Rollen oder Zangenvorzügen zwischen die beiden Packstoff-
bahnen geführt wird. Dabei kann auch ein Wirkstofffilm als
Bahnware - einbahnig oder mehrbahnig parallel im Abstand
10 zueinander - mit der gewünschten Breite der Dosiseinheiten
zugeführt werden. Anschließend werden Dosiseinheiten aus
dem bahnförmigen Wirkstofffilm durch eine Querschneidevor-
richtung vereinzelt, welche unmittelbar vor den Umlenk-
wellen positioniert ist. In einem weiteren Verfahrenss-
15 schritt werden die beiden Packstoffbahnen mit Hilfe eines
beheizten Siegelwerkzeuges derart gegeneinander gesiegelt,
daß die vereinzelt Dosiseinheiten in Kompartimenten
eingesiegelt werden und vollständig von Siegelnähten bzw.
Siegelflächen umgeben sind. In weiteren Verfahrensschritten
20 werden Perforationen zwischen den Kompartimenten einge-
stanzt und Primärverpackungseinheiten abgeteilt.

Für gewünschte Wafer mit einer anderen als quadratischen
oder rechteckigen Gestalt ist das Verfahren zur Herstellung
25 der Primärverpackungseinheit nach der DE 198 00 682 A1 wie
folgt gestaltet: In einem ersten Verfahrensschritt wird ein
Laminat aus dem bahnförmigen Wirkstofffilm und einer
Trägerfolie bereitgestellt, aus dem in einem weiteren
Schritt mit einer Stanzvorrichtung die Dosiseinheiten aus-
30 gestanzt werden, ohne daß die Trägerfolie durchgestanzt
wird. Das angestanzte Laminat wird anschließend mit Hilfe
von Rollen- oder Zangenvorzügen über eine Kante oder
Umlenkswelle so umgelenkt, daß sich dabei die Dosiseinheiten
von der Trägerfolie lösen. Bedarfsweise kann dazu zusätz-
35 lich auch ein Abstreifer verwendet werden. Danach werden
eine Packstoffoberbahn und eine -unterbahn ohne Kalt- oder

Heißverformung über jeweils eine Umlenkrolle aufeinandergeführt, wobei gleichzeitig die sich von der Trägerfolie ablösenden Dosiseinheiten zwischen die beiden Packstoffbahnen geführt werden. Anschließend werden die beiden
5 Packstoffbahnen mit Hilfe eines beheizten Siegelwerkzeuges derart gegeneinander gesiegelt, daß die vereinzelt Dosiseinheiten in Kompartimenten eingesiegelt werden und vollständig von Siegelnähten bzw. Siegelflächen umgeben sind. In weiteren Verfahrensschritten werden Perforationen
10 zwischen den Kompartimenten eingestanzt und Primärverpackungseinheiten abgeteilt. Es versteht sich von selbst, daß dieses Verfahren auch zur Herstellung und primären Einzelverpackung von quadratischen oder rechteckförmigen Wafern verwendet werden kann.

15 Aus der genannten DE 198 00 682 A1 sind auch Vorrichtungen zur Durchführung des jeweiligen Verfahrens bekanntgeworden. Eine dieser Vorrichtungen weist eine Vorratseinrichtung für ein Laminat aus einem Wirkstofffilm und einer Trägerfolie,
20 eine Schneid- bzw. Stanzeinrichtung für den Wirkstofffilm zum Stanzen eines Wafers auf der Trägerfolie, ein Trennwerkzeug zum Ablösen des Wirkstofffilms von der Trägerfolie, eine Vorzugseinrichtung für die Trägerfolie und damit auch den Wirkstofffilm mit dem Wafer, eine Packstoffzuführ- und -vorzugseinrichtung für zwei Packstoffbahnen, die den jeweiligen Wafer übernehmen, ein beheiztes Siegelwerkzeug für den Packstoff und ein Schneidwerkzeug zum Abtrennen des Siegelbeutels auf.

30 Das Wafermaterial ist elastisch und kann infolge der mechanischen Beanspruchung bei der Transportbewegung zwischen die Packstoffoberbahn und die -unterbahn seine Form und seine Abmessungen verändern, wobei die Gefahr besteht, daß sich auch die Wirkstoffmenge im vereinzelt
35 Wafer ändert, da ja die Fläche des Wafers maßgebend für die Dosierung des Wirkstoffs ist. Mit den vorbeschriebenen Ver-

fahren kann die geforderte Konstanz der Wirkstoffmenge nicht sichergestellt werden, da das Wafermaterial vor dem Einführen zwischen die Packstoffbahnen jeweils mechanisch beansprucht wird.

5

Es ist Aufgabe der Erfindung, ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Herstellung einer primären Einzelverpackung eines Wafer nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 und des Anspruchs 6 so zu gestalten, daß das Wafermaterial mechanisch unbelastet bleibt.

10

Diese Aufgabe wird bei einem Verfahren nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 und einer Vorrichtung nach dem Oberbegriff des Anspruchs 6 jeweils durch deren kennzeichnende Merkmale gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen sind in den jeweiligen Unteransprüchen aufgeführt.

15

Die erfindungsgemäße Verfahren besteht darin, daß ein Laminat aus einer Trägerfolie und einem Wirkstofffilm bereitgestellt und abgezogen wird, wobei die Trägerfolie vom Wirkstofffilm gelöst und separat aufgewickelt wird. Durch die Vorzugsbewegung der Trägerfolie wird auch der Wirkstofffilm vorwärtsbewegt. Mit seinem vorderen Ende wird dieser mechanisch belastungsfrei zwischen zwei ruhende Packstoffbahnen geführt, von diesen fixiert und zur Herstellung des Wafers im vorbestimmten rückwärtigen Abstand von diesen quergeschnitten. Anschließend wird der zwischen den Packstoffbahnen fixierte Wafer gemeinsam und synchron mit diesen vorgezogen, wobei die Vorzugskraft an den Packstoffbahnen angreift, und einer Siegelstation zugeführt. In dieser Siegelstation werden die Packstoffbahnen außerhalb des Anordnungsbereiches des Wafers zu einem Beutel gesiegelt, der im Anschluß daran von den Packstoffbahnen abgetrennt wird.

20

25

30

35

In bekannter Weise wird das Laminat im Coatingverfahren hergestellt und anschließend zu Streifen geschnitten, die aufgespult werden, wobei die Breite einer Spule der Breite des gewünschten Wafers oder eines Vielfachen dieser Waferbreite entspricht. Werden mehrere Wafer aus der Spule geschnitten, werden die einzelnen Wafer gespreizt und auf die Breite gebracht, die notwendig ist, um sie in die Packstoffbahnen einzufügen. Die Spule wird als Vorratsspule bereitgestellt. Der besondere Vorteil des Verfahrens liegt darin, daß der Wafer ohne mechanische Beanspruchung transportiert und geführt wird. Das Verfahren wird dabei so durchgeführt, daß die jeweilige Vorzugslänge der Trägerfolie und damit auch des Wirkstofffilms der gewünschten Länge eines Wafers entspricht, so daß die Wafer äußerst präzise reproduzierbar und stets gleich sind. Damit hat jeder Wafer auch die gleiche Wirkstoffdosis. Der vereinzelte Wafer wird danach während der Vorzugsbewegung der Packstoffbahnen über seine gesamte Ausdehnung zwischen diesen festgehalten und dabei mechanisch nicht belastet. Beim Siegeln der Packstoffbahnen zu einem Beutel besteht keine Gefahr einer Beschädigung des zwischen diesen fixierten Wafers. Das Verfahren ist einfach durchzuführen.

In einer bevorzugten Ausführung wird der von der Trägerfolie gelöste Wirkstofffilm in vertikaler Ausrichtung zwischen die bei diesem Verfahrensschritt ruhenden und im Abstand voneinander angeordneten Packstoffbahnen geführt. Anschließend werden diese an den Wafer angelegt und mit gleicher Vorzugsgeschwindigkeit und in gleicher Vorzugsrichtung beidseits des Wirkstofffilms vorgezogen, so daß der Wirkstofffilm mechanisch unbelastet zwischen den Packstoffbahnen mit vorgezogen wird. Am Einlauf des Wirkstofffilms werden die Packstoffbahnen dabei durch eine Klemmvorrichtung geführt, die die Packstoffbahnen am Ende des Arbeitstaktes, bei dem der Wirkstofffilm mit seinem vorderen Ende zwischen die Packstoffbahnen verbracht wurde, an

den Wafer andrückt und fixiert. Eine Relativbewegung zwischen diesem und den Packstoffbahnen ist dadurch ausgeschlossen. In dieser Position wird der Wirkstofffilm im vorbestimmten Abstand von der Klemmstation zur Abtrennung eines Wafers quergeschnitten und im nächsten Arbeitsschritt 5 vollständig und belastungsfrei zwischen die Packstoffbahnen eingezogen und mit vorgezogen.

Die Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens weist in 10 bekannter Weise eine Vorratseinrichtung für das aus einer Trägerfolie und einem Wirkstofffilm gebildete Laminat, ein Trennwerkzeug zum Ablösen des Wirkstofffilms von der Trägerfolie, eine Vorzugseinrichtung für diese und damit auch den Wirkstofffilm, ein Schneidwerkzeug für diesen, 15 eine Packstoffzuführ- und -vorzugseinrichtung für zwei Packstoffbahnen, die auch von einer Packstoffrolle kommen und mittels eines Trennverfahrens vereinzelt und umgelenkt werden können, ein beheiztes Siegelwerkzeug für den Packstoff und ein Schneidwerkzeug zum Abtrennen des fertigen 20 Siegelrandbeutels auf. Erfindungsgemäß ist die Packstoffzuführ- und -vorzugseinrichtung mit einer Aufnahme- und Klemmvorrichtung für das vordere Ende des Wirkstofffilms versehen, die in vertikaler Richtung unter dem Trennwerkzeug zum Ablösen des Wirkstofffilms und dem 25 Schneidwerkzeug für diesen angeordnet ist, derart, daß der von der Trägerfolie gelöste Wirkstofffilm während eines Vorschubtaktes in vertikaler Richtung nach unten in die Aufnahme- und Klemmvorrichtung gelangt. Dabei wird der Wirkstofffilm mechanisch nicht belastet.

30 Die Aufnahme- und Klemmvorrichtung ist bevorzugt aus Klemmrollen gebildet, zwischen denen die Packstoffbahnen gespannt geführt sind und die zwischen einer Aufnahme- 35 stellung für den Wirkstofffilm und einer Klemmstellung für diesen in horizontaler Richtung und somit quer zur Vorzugsrichtung des Wirkstofffilms gegenläufig zueinander be-

wegbar sind. Zur Bildung eines Einlauftrichters für den Wirkstofffilm können dabei zwei Paare von Klemmrollen übereinander angeordnet sein.

- 5 Die Erfindung wird nachstehend anhand eines Ausführungsbeispiels erläutert. In den zugehörigen Zeichnungen zeigen schematisch:

Fig.1: eine Vorrichtung zur Herstellung einer primären
10 Einzelverpackung eines Wafers und

Fig.2 bis 5: eine zugehörige Aufnahme- und Klemmvorrichtung für en Wafer in aufeinanderfolgen Verfahrensschritten.

- 15 Die in Fig. 1 gezeigte Vorrichtung weist eingangsseitig eine Vorratsspule 1 mit vorzuziehendem, aus einer Trägerfolie 2 und einem Wirkstofffilm 3 bestehendem Laminat 4, eine Umlenkrolle 5 und einen Abstreifer 6 zum Ablösen des Wirkstofffilms 3 von der Trägerfolie 2 und eine Spule 8 zum
20 Aufwickeln der Trägerfolie 2 auf. Unter der Trennrolle 7 sind zum exakten Ausrichten des von der Trägerfolie 2 gelösten Wirkstofffilms 3 Führungsbahnen oder -leisten 9, eine Querschneidvorrichtung 10 mit einem Messer (nicht weiter dargestellt) und eine Packstoffzuführ- und -vorzugs-
25 einrichtung 11 für zwei Packstoffbahnen 12 angeordnet, die schneidvorrichtungsseitig eine aus zwei Paaren von übereinander angeordneten Klemmrollen 13 und 14 gebildete Aufnahme- und Klemmvorrichtung aufweist. Die Packstoffbahnen 12 sind auf Vorratsrollen 15 angeordnet und über die
30 Klemmrollen 13 und 14 zu Vorzugsrollen 16 geführt, durch die sie klemmend fixiert sind und vorgezogen werden, wodurch sie auch gespannt an den Klemmrollen 13 und 14 anliegen. Zwischen diesen (13, 14) und den Vorzugsrollen 16 sind beheizte Quersiegel- und Längssiegelwerkzeuge 17 und
35 18 und in Vorzugsrichtung nach den Vorzugsrollen 16 ein Flachmesser 19 als Querschneidwerkzeug angeordnet.

Zur Herstellung einer primären Einzelverpackung eines Wafers wird Laminat 4 mit der vorbestimmten Breite des Wafers in der vorbestimmten Länge desselben von der Vorratsspule 1 durch eine Betätigung der Spule 8 abgezogen. 5 Dabei wird der Wirkstofffilm 3 durch die Trennwalze 7 von der Trägerfolie 2 gelöst und vertikal nach unten durch die Führungsbahnen oder -leisten 9 ausgerichtet, wobei diese keine Klemmfunktion gegenüber dem Wirkstofffilm 3 haben. Bei diesem Vorgang gelangt das vordere Ende des Wirkstoff-

10 films 3 zwischen die in ihrer Aufnahmeposition im Abstand voneinander befindlichen Klemmrollen 13 und 14, über die wirkstofffilmseitig die Packstoffbahnen 12 geführt sind und in der Aufnahmeposition gespannt an diesen anliegen. Die Packstoffbahnen 12 sind vom vorhergehenden Zyklus mit einer

15 Quersiegelnaht 20 versehen, die nun die Front- oder Boden-naht des herzustellenden Siegelrandbeutels bzw. der primären Einzelverpackung des Wafers darstellt. Dieser Verfahrensschritt ist in Fig. 2 dargestellt. Im nächsten Verfahrensschritt (Fig. 3) werden die Packstoffbahnen 12

20 durch die Klemmrollen 13, 14 an den vorderen Bereich des vorgezogenen Wirkstofffilms 3 angedrückt und dieser zwischen den Packstoffbahnen 12 fixiert, indem diese (13, 14) aufeinander zu bewegt werden. Vom Wirkstofffilm 3 wird nun ein Wafer 21 in der vorbestimmten Länge durch die Quer-

25 schneidvorrichtung 10 abgetrennt. Danach werden die Packstoffbahnen 12 mit dem zwischen diesen geklemmten Wafer durch eine synchrone Betätigung der Vorzugsrollen 16 bis zur Position der rückseitigen Quersiegelnaht vorgezogen (Fig. 4), wobei der Wafer 21 reibungsfrei und mit der

30 gleichen Geschwindigkeit wie die Packstoffbahnen 12 bewegt wird. In dieser Position werden die Packstoffbahnen 12 an den beiden Längsseiten durch die beiden Längssiegelwerkzeuge 18 und an der hinteren Querseite durch das Quersiegelwerkzeug 17 miteinander heißversiegelt. Die

35 entstehende Quersiegelnaht ist dabei so breit gewählt, daß diese quergeteilt werden kann und sowohl die rückseitige

Siegelnaht der gerade gefertigten, jedoch noch zu vereinzelnden primären Einzelverpackung als auch die Fornt- oder Bodennaht der nachfolgenden Einzelverpackung ergibt. Im Anschluß an das Siegeln werden die Klemmrollen 13, 14 in ihre Aufnahme-
5 position verbracht und somit geöffnet. In Fig. 5 ist dieser Verfahrensschritt dargestellt. Der nächste Zyklus beginnt wieder mit dem Einführen des Wirkstofffilms zwischen die in der Aufnahme-
10 position befindlichen Klemmrollen 13 und 14, wie vorstehend beschrieben ist. Nach jedem Zyklus wird eine auf diese Weise hergestellte primäre Einzelverpackung 22 eines Wafers 21 durch das Flachmesser 19 von der nachfolgenden Einzelverpackung abgetrennt.

15

20

25

30

35

40

B E Z U G S Z E I C H E N L I S T E

	1	Vorratsspule
5	2	Trägerfolie
	3	Wirkstofffilm
	4	Laminat
	5	Umlenkrolle
	6	Abstreifer
10	7	Trennrolle
	8	Spule
	9	Führungsbahnen oder -leisten
	10	Querschneidvorrichtung
	11	Packstoffzuführ- und -vorzugseinrichtung
15	12	Packstoffbahn
	13	Klemmrolle
	14	Klemmrolle
	15	Vorratsrolle
	16	Vorzugsrolle
20	17	Quersiegelwerkzeug
	18	Längssiegelwerkzeug
	19	Flachmesser
	20	Quersiegelnaht
	21	Wafer
25	22	Einzelverpackung

P A T E N T A N S P R Ü C H E

1. Verfahren zur Herstellung einer primären Einzelverpackung eines Wafers, bei dem ein Laminat aus einer Trägerfolie und einem Wirkstofffilm bereitgestellt wird, der Wirkstofffilm mit vorbestimmter Länge quergeschnitten und von der Trägerfolie gelöst wird, zwischen zwei Packstoffbahnen geführt und mit diesen einer Siegelstation zugeführt wird, die Packstoffbahnen zu einem Beutel gesiegelt und dieser von den Packstoffbahnen abgetrennt wird, dadurch gekennzeichnet, daß die vom Wirkstofffilm (3) gelöste Trägerfolie (2) in der vorbestimmten Länge des Wafers (21) vorgezogen und gleichzeitig der von dieser gelöste Wirkstofffilm (3) mit seinem vorderen Ende mechanisch belastungsfrei zwischen die ruhenden Packstoffbahnen (12) geführt, von diesen aufgenommen und fixiert und im Abstand von diesen zu einem Wafer (21) mit der vorbestimmten Länge quergeschnitten wird, und daß anschließend der Wafer (21) gemeinsam und synchron mit den Packstoffbahnen (12) vorgezogen und der Siegelstation (17/ 18) zugeführt wird, in der die Packstoffbahnen (12) außerhalb des Bereiches des zwischen diesen fixierten Wafers (21) gesiegelt werden.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der von der Trägerfolie (2) gelöste Wirkstofffilm (3) in vertikaler Ausrichtung zwischen die beidseits desselben einlaufenden Packstoffbahnen (12) geführt wird.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Lösen des Wirkstofffilmes (3) von der vorgezogenen Trägerfolie (2) an einer Kante oder Umlenkrolle (5) erfolgt.

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß das Lösen des Wirkstofffilms (3) von der Trägerfolie (2) mit Unterstützung eines Abstreifers (6) erfolgt, der zwischen dem Wirkstofffilm (3) und der Trägerfolie (2) angeordnet ist.
5. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Packstoffbahnen (12) am Einlauf des Wirkstofffilms (3) in die Packstoffzuführ- und -vorzugseinrichtung (11) über eine Klemmvorrichtung (13/ 14) geführt sind, durch die die Packstoffbahnen (12) während des Abtrennens des Wafers (21) vom Wirkstofffilm (3) und während ihres nachfolgenden Vorzuges an diesen derart angedrückt werden, daß eine Relativbewegung zwischen dem Wafer (21) und den Packstoffbahnen (12) ausgeschlossen ist.
6. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens zur Herstellung einer primären Einzelverpackung eines Wafers, mit einer Vorratseinrichtung für ein Laminat aus einem Wirkstofffilm und einer Trägerfolie, einer Trennrolle zum Ablösen des Wirkstofffilms von der Trägerfolie, einer Vorzugseinrichtung für die Trägerfolie und damit auch den Wirkstofffilm, einer Querschneidvorrichtung für den Wirkstofffilm, einer Packstoffzuführ- und -vorzugseinrichtung für zwei Packstoffbahnen, einem beheizten Siegelwerkzeug für den Packstoff und mit einem Schneidwerkzeug zum Abtrennen des Siegelbeutels, dadurch gekennzeichnet, daß die Packstoffzuführ- und -vorzugseinrichtung (11) mit einer Aufnahme- und Klemmvorrichtung (13/ 14) für das vordere Ende des Wirkstofffilms (3) versehen ist, die in vertikaler Richtung unter der Trennrolle (7) und der Querschneidvorrichtung (10) angeordnet ist.

7. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet,
daß die Aufnahme- und Klemmvorrichtung aus Klemmrollen
(13, 14) gebildet ist, zwischen denen die Packstoff-
bahnen (12) geführt sind, wobei die Klemmrollen (13,
5 14) zwischen einer Aufnahmestellung und einer Klemm-
stellung für den Wirkstofffilm (3) quer zu diesem
gegenläufig zueinander bewegbar sind.

8. Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet,
10 daß zwei Paare von Klemmrollen (13, 14) übereinander
angeordnet sind.

15

20

25

30

35

Z U S A M M E N F A S S U N G

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Herstellung einer primären Einzelverpackung eines Wafers, bei denen ein Laminat aus einer Trägerfolie und einem Wirkstofffilm mit vorbestimmter Länge quergeschnitten und von der Trägerfolie gelöst wird, zwischen zwei Packstoffbahnen geführt und mit diesen einer Siegelstation zugeführt wird, die Packstoffbahnen zu einem Beutel gesiegelt und dieser von den Packstoffbahnen abgetrennt wird. Sie löst die Aufgabe, das Verfahren und die Vorrichtung so zu gestalten, daß das Wafermaterial mechanisch unbelastet bleibt. Das Verfahren sieht vor, daß die vom Wirkstofffilm (3) gelöste Trägerfolie (2) in der vorbestimmten Länge des Wafers (21) vorgezogen und gleichzeitig der von dieser gelöste Wirkstofffilm (3) mit seinem vorderen Ende mechanisch belastungsfrei zwischen die ruhenden Packstoffbahnen (12) geführt, von diesen aufgenommen und fixiert und im Abstand von diesen zu einem Wafer (21) mit der vorbestimmten Länge quergeschnitten wird, und daß anschließend der Wafer (21) gemeinsam und synchron mit den Packstoffbahnen (12) vorgezogen und der Siegelstation (17/ 18) zugeführt wird. Die Vorrichtung ist dazu mit einer Packstoffzuführ- und -vortragseinrichtung (11) mit einer Aufnahme- und Klemmvorrichtung (13/ 14) für das vordere Ende des Wirkstofffilms (3) versehen, die in vertikaler Richtung unter der Trennrolle (7) und dem Querschneidwerkzeug (10) angeordnet ist.

(Fig. 1)

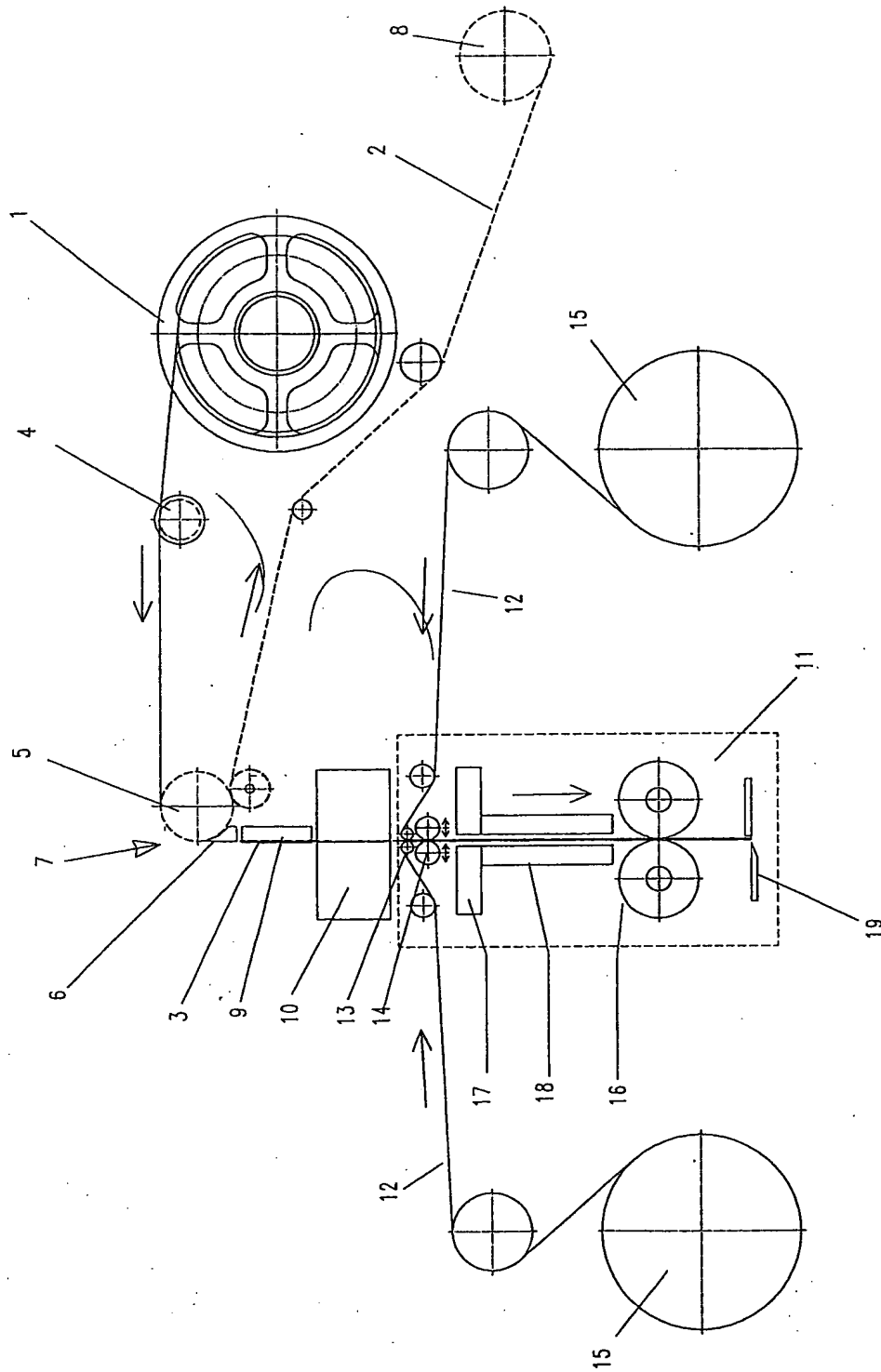


FIG. 1

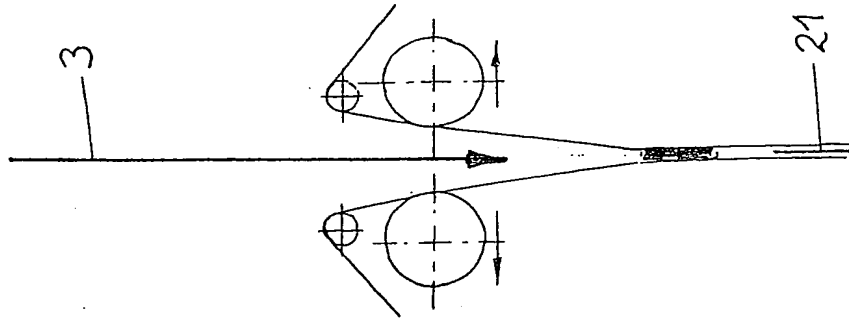


FIG. 5

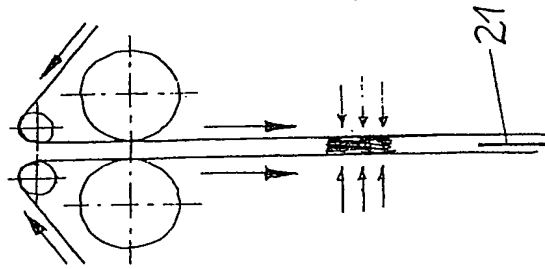


FIG. 4

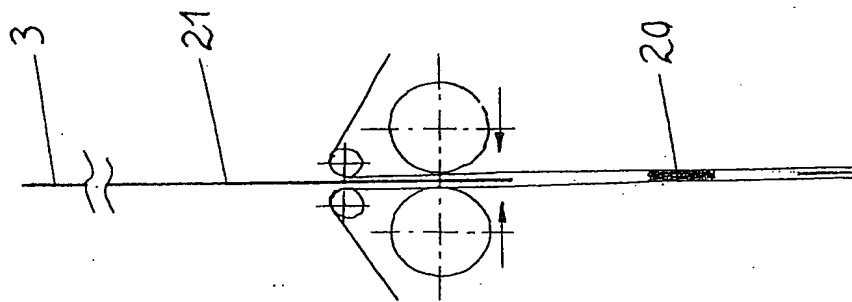


FIG. 3

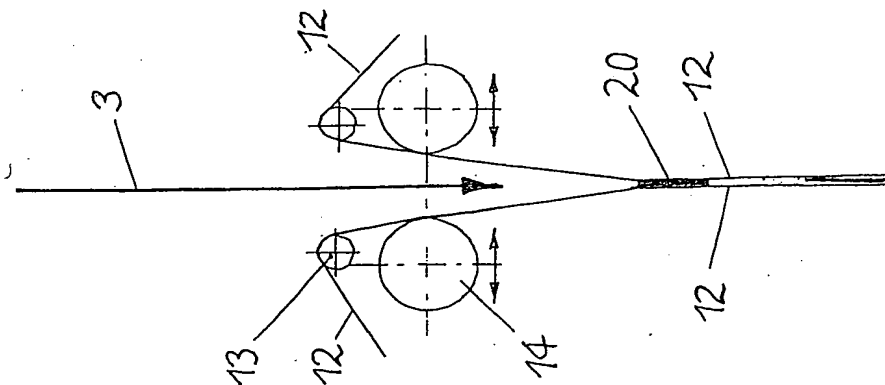


FIG. 2